
Low Profile Battery Connector (ロー プロファイル バッテリー コネクタ)

1. 適用範囲**1.1 内容**

本規格はロー プロファイルバッテリーコネクタの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。適用製品名と型番は附表 2の通りである。

2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

2.1 Tyco Electronics 規格

A. 501-78523: 認定試験報告書

2.2 関連適用規格

A. MIL-STD-202: 電子・電気部品の試験方法

B. EIA 364: Test specification

1. Scope:**1.1 Contents:**

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of the Low Profile Battery Connector. Applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix 2.

2. Applicable documents:

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 Tyco Electronics specifications :

A. 501-78523: Test report

2.2 Commercial standards and specifications:

A. MIL-STD-202: Test methods for electronic and electrical component parts.

B. EIA 364: Test specification

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材 料

A. コンタクト

- ・材料: 銅合金
- ・表面処理: 全面ニッケル下地 めっき
接点部 金めっき
半田付け部 金フラッシュめっき

B.ハウジング

- ・熱可塑性樹脂
- ・色: 黒色

C. ソルダーペグ

- ・材料: 銅合金
- ・表面処理: 全面ニッケル下地めっき、
半田付け部 金フラッシュめっき

3.3 定 格

A. 定格電圧: 30V DC

B. 定格電流: 2A/1極

C. 使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

但し、使用温度の上限には通電による温度上昇分を含む

3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig.1 に規定された電氣的、機械的、及び耐環境的性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

3. Requirements:

3.1 Design and construction:

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 Materials:

A. Contact

- ・Material: Copper alloy
- ・Finish: Nickel-under plated all over.
Gold plated at contact area.
Gold flash plated at soldering area.

B. Housing

- ・Thermoplastic molding compound
- ・Color: Black

C. Solder Peg

- ・Material: Copper alloy
- ・Finish: Nickel-under plated all over.
Gold flash plated at soldering area.

3.3 Ratings:

A. Voltage rating: 30V DC

B. Current rating: 2A /Contact

C. Temperature rating: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$

High limit temperature includes raised temperature by operation.

3.4 Performance requirements and test descriptions:

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 1. All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test requirements and procedures summary

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test items	Requirements	Procedures
3.5.1	製品の確認	・製品図面の必要条件に合致していること	・目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷を検査する
	Examination of product	・Meets requirements of product drawing	・Visual inspection ・No physical damage
電 気 的 性 能			
Electrical Requirements			
3.5.2	総合抵抗 (ローレベル)	・35mΩ 以下: 1.0mmストローク時(初期) ・40mΩ 以下: 1.0mmストローク時(終期)	・ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクトを開路電圧 20 mV 以下、閉路電流 100 mA 以下の条件で測定する。 ・Fig.2 参照 ・EIA 364-23
	Termination resistance (Low level)	・35mΩ Max. : 1.0mm stroke(Initial) ・40mΩ Max. : 1.0mm stroke(Final)	・Subject mated contacts assembled in housing to 20 mV Max. open circuit at 100 mA ・See Fig.2 ・EIA 364-23
3.5.3	耐電圧	・沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと ・リーク電流 1mA 以下	・500VAC 1 分間印加 ・コネクタ嵌合なし ・隣接コンタクト間で測定 ・EIA 364-20
	Dielectric withstanding voltage	・Neither creeping discharge nor flashover shall occur ・Current leakage: 1mA Max.	・500VAC for 1 minute. ・Test between adjacent circuits of unmated connectors ・EIA 364-20
3.5.4	絶縁抵抗	・100 MΩ 以上	・100V DC 1 分間印加 ・コネクタ嵌合なし ・隣接コンタクト間で測定 ・EIA 364-21
	Insulation resistance	・100MΩ Min.	・100V DC for 1 minute. ・Test between adjacent circuits of unmated connectors ・EIA 364-21
3.5.5	温度上昇	・定格電流を通電して、温度上昇は30°C以下	・通電による温度上昇を測定すること。 ・EIA 364-70 Method 2
	Temperature rising	・30°C Max. under loaded rating current	・Measure temperature rising by energized current ・EIA 364-70 Method 2

Fig. 1 (続く)

Fig. 1 (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test items	Requirements	Procedures
機 械 的 性 能			
Mechanical Requirements			
3.5.6	コンタクト接圧	・1.0 N 以上/ 1.0mm 変位 (初期)	・Fig.3 参照
	Contact normal force	・1.0 N Min./ 1.0mm stroke (Initial)	・See Fig.3
3.5.7	耐久性 (繰り返し挿抜)	・総合抵抗 40mΩ 以下 ・コンタクト接圧 初期接点位置 から1.0mmのストローク位置で 初期値の70%以上	・1.0mm ストロークで嵌合、離脱を行う ・挿抜速度: 10~20サイクル/分 ・挿抜回数: 5000サイクル ・Fig.3 参照 ・EIA 364-9
	Durability (Repeated mating / un- mating)	・Termination resistance 40mΩ Max. ・Contact normal force should be more than 70% of initial force at 1.0mm stroke from initial contact point	・1.0mm stroking ・Operation speed: 10~20cycles/min. ・Number of cycles: 5000 cycles ・See Fig.3 ・EIA 364-9
3.5.8	耐久性 (繰り返し挿抜, フルストローク)	・総合抵抗 40mΩ 以下 ・コンタクト接圧 初期接点位置 から1.0mmのストローク位置で 初期値の70%以上	・フルストロークで嵌合、離脱を行う ・挿抜速度: 10~20サイクル/分 ・挿抜回数: 200サイクル ・Fig.3 参照 ・EIA 364-9
	Durability (Repeated mating / un- mating, Full stroke)	・Termination resistance 40mΩ Max. ・Contact normal force should be more than 70% of initial force at 1.0mm stroke from initial contact point	・Full stroking ・Operation speed: 10~20cycles/min. ・Number of cycles: 200 cycles ・See Fig.3 ・EIA 364-9
3.5.9	振動 (低周波)	・振動中 1 μ sec. をこえる不連続 導通を生じないこと ・総合抵抗 40mΩ 以下	・嵌合したコネクタに1.52mmの振幅で、 10-55-10 Hzに毎分1サイクルの割合で変化 する掃引振動を直交する三方向軸に2時間ず つ与えること。100mAを通電 ・EIA 364-28 Condition I
	Vibration (Low frequency)	・No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. ・Termination resistance 40mΩ Max.	・Mated connectors to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.52mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular Planes, 100mA applied ・EIA 364-28 Condition I

Fig. 1 (続く)

Fig. 1 (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test items	Requirements	Procedures
3.5.10	衝撃	<ul style="list-style-type: none"> ・衝撃により1 μ sec. をこえる不連続導通を生じないこと ・総合抵抗 40m Ω 以下 	<ul style="list-style-type: none"> ・加速度: 490m/s²(50G) ・衝撃パルス波型:半波正弦波 ・接続時間: 11m sec. ・衝撃回数: X, Y, Z 軸正逆方向に各3回 合計18回、100mAを通电 ・EIA 364-27 Method A
	Physical shock	<ul style="list-style-type: none"> ・No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur ・Termination resistance 40m Ω Max. 	<ul style="list-style-type: none"> ・Accelerated Velocity: 490m/s²(50G) ・Waveform: Half sin ・Duration: 11m sec. ・Number of drops: 3 drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes, totally 18 drops. 100mA applied ・EIA 364-27 Method A
3.5.11	はんだ付け性	<ul style="list-style-type: none"> ・95 % 以上ぬれていること 	<ul style="list-style-type: none"> ・はんだ温度: 245 \pm 5 $^{\circ}$C ・はんだ浸漬時間: 3 \pm 0.5 秒 ・使用フラックス: アルファー 100 ・EIA 364-52
	Solderability	<ul style="list-style-type: none"> ・Wet solder coverage: 95 % Min. 	<ul style="list-style-type: none"> ・Solder temperature: 245 \pm 5 $^{\circ}$C ・Immersion duration: 3 \pm 0.5 sec. ・Flux: Alpha 100 ・EIA 364-52
環 境 的 性 能			
Environmental Requirements			
3.5.12	熱衝撃	<ul style="list-style-type: none"> ・総合抵抗 40m Ω 以下 	<ul style="list-style-type: none"> ・嵌合したコネクタ ・-40$^{\circ}$C /30分、85$^{\circ}$C /30分 これを 1 サイクルとし 10サイクル行う ・EIA 364-32
	Thermal shock	<ul style="list-style-type: none"> ・Termination resistance 40m Ω Max. 	<ul style="list-style-type: none"> ・Mated connector ・-40$^{\circ}$C /30min. 85$^{\circ}$C /30 min. Making this a cycle, repeat 10 cycles ・EIA 364-32
3.5.13	温度寿命 (耐熱)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合抵抗 40m Ω 以下 	<ul style="list-style-type: none"> ・嵌合したコネクタを85$^{\circ}$Cの環境下に 240時間放置する ・EIA 364-17
	Temperature life (Heat aging)	<ul style="list-style-type: none"> ・Termination resistance 40m Ω Max. 	<ul style="list-style-type: none"> ・Mated connector 85$^{\circ}$C, Duration :240 hours ・EIA 364-17

Fig. 1 (続く)
Fig. 1 (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test items	Requirements	Procedures
3.5.14	耐湿性 (定常状態)	<ul style="list-style-type: none"> 総合抵抗 40mΩ 以下 絶縁抵抗 100MΩ 以上 耐電圧3.5.3を満足すること 	<ul style="list-style-type: none"> 嵌合した状態のコネクタにおいて 90~95 %RH, 60°C, 240 時間放置後、常温常湿中で1時間放置後測定 EIA 364-31 Method II, Condition B
	Humidity (Steady state)	<ul style="list-style-type: none"> Termination resistance 40mΩ Max. Insulation resistance 100MΩ Min. Dielectric withstanding voltage To meet the spec 3.5.3 	<ul style="list-style-type: none"> Mated connector 90~95 %RH, 60°C 240hours Measure after leaving 1hour in the room temperature & humidity EIA 364-31 Method II, Condition B
3.5.15	温湿度サイクル	<ul style="list-style-type: none"> 総合抵抗 40mΩ 以下 	<ul style="list-style-type: none"> 嵌合したコネクタ 25~65°C、90~95%R.H. 24時間を1サイクルとし、10サイクル行う -10°C 寒冷衝撃は実施する EIA 364-31 Method III
	Humidity-temperature cycling	<ul style="list-style-type: none"> Termination resistance 40mΩ Max. 	<ul style="list-style-type: none"> Mated connector 25~65°C, 90~95% R.H. 24 hours Making this a cycle, repeat 10 cycles Cold shock -10°C performed EIA 364-31 Method III
3.5.16	塩水噴霧	<ul style="list-style-type: none"> 総合抵抗 40mΩ 以下 コネクタの機能を損なうような腐食が無い事 	<ul style="list-style-type: none"> 嵌合したコネクタにて、5 %、35°Cの塩水噴霧に48時間さらすこと EIA 364-26 Condition B
	Salt spray	<ul style="list-style-type: none"> Termination resistance 40mΩ Max. No corrosion that damages function of connector allowed 	<ul style="list-style-type: none"> Mated connectors with 5 %, 35°C concentration for 48 hours EIA 364-26 Condition B
3.5.17	工業ガス (SO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> 総合抵抗 40mΩ 以下 コネクタの機能を損なうような腐食が無い事 	<ul style="list-style-type: none"> 嵌合したコネクタ SO₂ガス : 10ppm, 75 % R. H. 40°C, 48時間
	Industrial gas (SO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> Termination resistance 40mΩ Max. No corrosion that damages function of connector allowed 	<ul style="list-style-type: none"> Mated connector SO₂ Gas: 10ppm, 75 % R. H. 40°C, 48 hours
3.5.18	はんだ耐熱性	<ul style="list-style-type: none"> 試験後物理的損傷を生じないこと 	<ul style="list-style-type: none"> コテ先温度 : 380±10°C, 5秒以内 但し、タイン部に加圧なき事 EIA 364-56
	Resistance to soldering heat	<ul style="list-style-type: none"> No physical damage shall occur 	<ul style="list-style-type: none"> Soldering iron temperature : 380±10°C 5sec. Max. No pressurize a tine EIA 364-56
3.5.19	耐リフロー性	<ul style="list-style-type: none"> 外観異常の無きこと 	<ul style="list-style-type: none"> 温度プロファイルはFig.4参照 EIA 364-56
	Resistance to reflow heat	<ul style="list-style-type: none"> No physical damage allowed 	<ul style="list-style-type: none"> Temperature profile; See Fig. 4 EIA 364-56

Fig. 1 (終り)

Fig. 1 (End)

3.6 製品認定試験の試験順序

3.6 Product qualification test sequence

附表 1
Appendix 1

試験項目	Test examination	試験グループ/Test group												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		試験順序/Test sequence (a)												
製品の確認	Examination of product	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	1,3
総合抵抗 (ローレベル)	Termination resistance (Low level)	3,6	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5			
耐電圧	Dielectric withstanding voltage							2,5						
絶縁抵抗	Insulation resistance							3,6						
温度上昇	Temperature rising											3		
コンタクト接圧	Contact normal force		4,6	4,6										
耐久性 (繰り返し挿抜)	Durability(Repeated mating /un-mating)		5											
耐久性 (繰り返し挿抜, フルストローク)	Durability(Repeated mating /un-mating, Full stroke)			5										
振動(低周波)	Vibration (Low frequency)	4												
衝撃	Physical shock	5												
はんだ付け性	Solderability												2	
熱衝撃	Thermal shock				4									
温度寿命 (耐熱)	Temperature life (Heat aging)					4								
耐湿性 (定常状態)	Humidity (Steady state)						4	4						
温湿度サイクル	Humidity-temperature cycling								4					
塩水噴霧	Salt spray									4				
工業ガス(SO ₂)	Industrial gas (SO ₂)										4			
はんだ耐熱性	Resistance to soldering heat													2
耐リフロー性	Resistance to reflow heat	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/ (a)Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

適用製品名と型番は附表 2 の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix.2.

附表 2
Appendix 2

型番 Product Part No.	品名	Description
2229056-1	ロープロファイル バッテリーコネクタ、3極	Low Profile Battery Connector, 3 Pos.

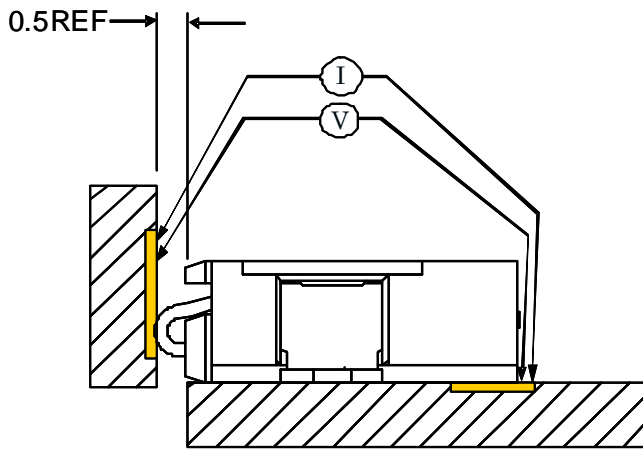


Fig.2 総合抵抗測定点
Fig.2 Termination resistance measuring points

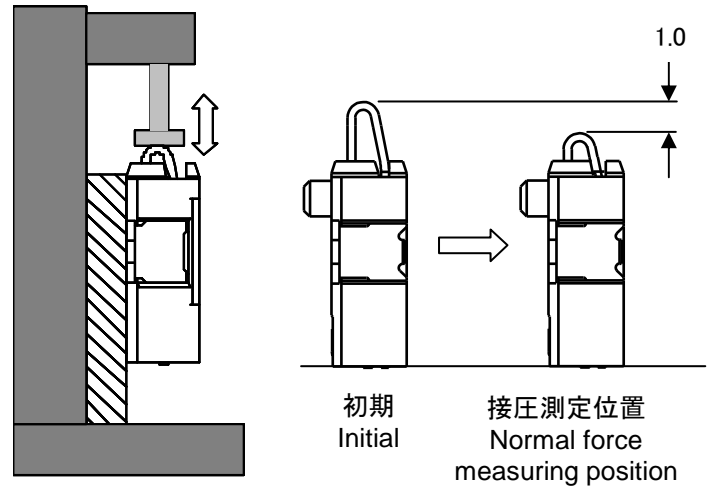
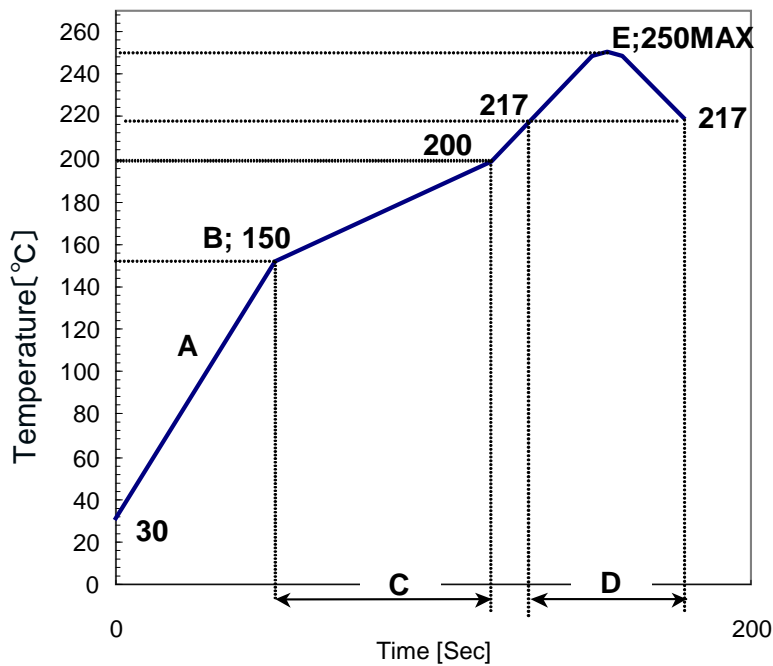


Fig.3 コンタクト接圧測定方法
Fig.3 Contact normal force measuring method



	条件 (Condition)
A: 昇温速度 (The speed of temperature rising)	3°C/sec Max.
B: プリヒート開始温度 (The start temperature of pre-heating)	150~200°C
C: プリヒート時間 (Time of pre-heating)	60~180sec.
D: 217°C以上時間 (Time of upper 217 °C)	60sec MIN. 150sec MAX.
E: ピーク温度 (Temperature of peak point)	250°C

※ リフロー回数は、2回 / Number of reflow times; 2 times.

Fig.4 IR リフロー温度プロファイル
Fig.4 Temperature profile for IR reflow.